1.2 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：杭州电子科技大学芯片流片服务项目

项目编号：ZJ-2270364-02

元人民币

序号	费用名称	数量	单价	总价	备注
1	12吋28nm工艺工程样品硅片	12张	37,290.00	447,480.00	
2	28nm CMOS 工艺Full mask	1套	9,002,520.00	9,002,520.00	
3	售后服务	1年	200,000.00	200,000.00	
投标总价（小写）		9,650,000.00元			
投标总价（大写）		玖佰陆拾伍万元整			

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2. 上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人（盖公章或电子签章）：

日期：　　2022-04-19